

图书基本信息

书名：<<电子封装技术丛书-集成电路封装试验手册>>

13位ISBN编号：9787505349094

10位ISBN编号：7505349090

出版时间：1998-08-01

出版时间：电子工业出版社

作者：王先春

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>